

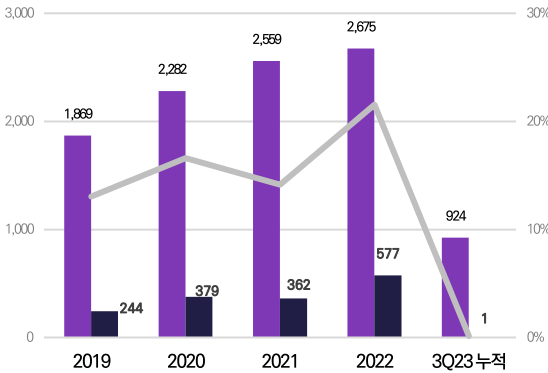
테크윙 컨콜노트

탐방일자: 2024년 1월 22일(월)

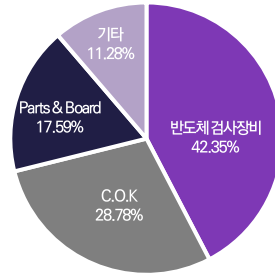
정리일자: 2024년 1월 28일(일)

▶ 기업정보

(단위: 억원, %)



3Q23 기준



▶ 회사정보 (탐방 당일 종가 기준)

시가총액	5,896억원
현재주가	16,000원
최대주주	13.34%
유동주식 비율	82.32%
외국인 지분율	7.04%
오버행 여부	-

▶ 한줄 기업개요

- 2002년 설립, 2011년 코스닥 시장에 상장한 테스트 핸들러 및 후공정 검사 장비기업

▶ 투자포인트

1) 본업 실적 개선 및 사업 영역 확장 본격화

- 동사는 2019년부터 꾸준히 높은 매출 성장 기록했으나, 지난해 고객사 투자 지연에 따라 어려운 한 해를 보냄
- 메모리 핸들러 글로벌 점유율 1위 업체로 장비의 지속적인 업그레이드를 통해 꾸준히 점유율 유지할 전망
- 비메모리 시장 점유율은 꾸준히 증가할 것으로 기대(2022년 4~5%에서 2025년 10% 초반 목표)
- 신규 장비 Probe station을 통해 기존 패키징 이후 핸들러 장비에서 웨이퍼 테스트 영역으로 확장
- 올해는 실적이 좋았던 2022년 대비해서 매출 성장 가능할 것으로 기대

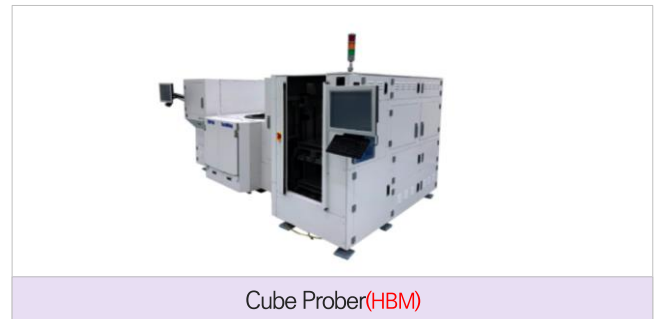
2) HBM 테스트 위한 Cube Prober 수주 기대

- 현재 HBM은 전수 조사가 아닌 샘플 검사 형태로 테스트 진행 중
- 동사의 Cube Prober 장비를 통해 전수 검사 가능
- 고객사와 테스트 중으로 올해 수주 및 양산 기대
- 256para 수준의 스펙과 프로브 검사 및 양품 검사 기능 동시 탑재로 높은 제품 경쟁력 보유
- 기존 장비 대비 높은 가격과 고수익성 가능할 것

▶ 결론

동사는 2019년부터 높은 매출 성장과 더불어 20% 수준의 고마진 기업으로 성장했으나, 지난해 고객사 투자 지연으로 부진한 한 해를 보냄. 올해는 기존 글로벌 시장점유율 1위인 메모리 핸들러 업황이 점차 회복할 것으로 예상됨. 동사는 메모리 핸들러 시장 대비 3배 이상 큰 규모인 비메모리 핸들러 시장 점유율을 높여가고 있으며, 신규 장비를 통해 웨이퍼 테스트 영역까지 타겟 시장을 확장하고 있음. 여기에 고객사의 HBM 수율 문제를 해결해 줄 수 있는 HBM 테스트용 Cube Prober 장비를 개발해 올해 테스트 이후 수주를 기대하고 있음. 따라서 올해 드라마틱한 실적 개선에 더해 멀티플 상향까지 동시에 이뤄지는 한해가 될 것으로 기대됨.

▶ 주요제품 사진



▶ 주요 제품

1) 테스트 핸들러

- 반도체 후공정인 검사공정에 들어가는 자동화 장비, 테스터 검사 결과에 따라 양품과 불량품을 자동으로 분류
- 제품으로는 메모리 테스트 핸들러, Burn-in Chamber, 비메모리(Logic) 테스트 핸들러, 모듈 핸들러가 있음
- 테스트 핸들러 경쟁사(일본 어드반테스트, 미래산업, 세메스), 비메모리 핸들러 경쟁사(델타 디자인, 세이코엠펜 등)
- 메모리 핸들러 ASP(평균판매단가): 약 5억~10억원, 비메모리 핸들러 ASP: 2억~5억원 후반(장비 Size, 스펙 구성에 따라 다름)
- 메모리 핸들러 글로벌 M/S 1위
- 메모리 핸들러 고객사(마이크론, SK하이닉스, 키옥시아 등), 비메모리 핸들러 고객사(암코 테크놀로지, ASE 등)

2) C.O.K(Change over kit)

- 핸들러 내 검사환경을 조성하는 소모성 부품(트레이), 다른 종류 반도체 소자 검사시 교체 필요
- 핸들러보다 수익성이 2배 정도 높음. 세트 당 ASP 2,000~3,000만원

3) 신사업

- 프로브 스테이션 장비 : 패키징 전 제품의 전자적 특성을 측정하기 위해 테스터와 피측정체를 연결하는 장비
- HBM 테스트 용 Cube Prober : 현재 HBM은 전수 조사가 아닌 샘플 조사 형태, 동사 장비를 통해 전수 조사 가능
최대 256para 수준의 스펙 탑재, 프로브 검사와 양품 검사 기능 동시 탑재로 독보적 경쟁력 확보

IR 담당자와의 Q&A

Q1) 프로브 스테이션 장비 상세 설명 및 경쟁사는?

A1) 웨이퍼가 양산되면 웨이퍼 자르기 전에 프로브카드에 접촉시켜 웨이퍼가 양품인지 불량인지 각 다이별로 핸들링해주는 장비. 기존 후공정 패키징 이후 시장이 타겟이었다면 해당 장비는 패키징 전 웨이퍼 테스트 시장 진입으로 생각하면 됨. 일본 아크레텍. 국내는 세메스, 세믹스(비상장), 소규모 업체도 존재. 메모리 핸들러 대비 단가 높고 수요 많음. 시장 규모 약 1조원 추정.

Q2) 프로브 스테이션 시장규모, MS 목표는?

A2) 약 1조원 정도로 추정. 2025년 5~10% 정도 목표.

Q3) HBM 장비 설명 ?

A3) 현재 HBM은 전수조사가 아니라 샘플검사의 형태로 진행 중. 동사 장비가 들어가면 전수검사가 가능할 것으로 보여짐. 웨이퍼 적층 이후 자른 걸 가지고 양품인지 아닌지 전반적인 테스트 가능. 약 6년 전부터 비슷한 컨셉 프로젝트 하다가 중단됐는데, HBM이 부각되면서 다시 가동됨. 가격은 메모리 핸들러보다 상당히 고가, 마진도 좋을 것으로 예상.

Q4) 올해 수주 물량 예상 ?

A4) 어느 정도 나올지는 알 수 없음. HBM 공급이 수요를 못 따라가는 것으로 알고 있음. 테스트도 상대적으로 빠르게 진행될 것으로 기대.

Q5) HBM 장비도 테스터랑 같이 들어가는 구조인지?

A5) 맞음. 테스터와 접촉시켜주는 장비로 생각하면 됨.

Q6) HBM 장비 경쟁은 없는지?

A6) 현재 어드반테스트 정도. 동사 장비가 파라수, 공간차지, 가격 모두에서 강점이 있음.

Q7) 비메모리 핸들러 시장 규모, MS 목표는?

A7) 메모리 핸들러 시장 규모가 3,500억원 정도 추정. 비메모리 핸들러 시장은 8~9,000억원 시장 정도 추정. 동사는 2022년 기준 약 5% 정도. 2025년 시장점유율 10% 초반 목표.

Q8) 비메모리 핸들러에서 동사 강점은 ?

A8) 고온, 상온, 저온을 모두 다루는 Tri-Temp 기술 보유. 글로벌 3개 업체(대만 혼텍, 미국 코후, 동사)만 보유한 기술.

Q9) COK 교체주기는?

A9) 일단 외형 변화가 필요할 때 교체 필요. 따라서 DDR4에서 DDR5로 갈때 교체가 필요함. 그 외에도 테스트가 많아지면 교체가 빨라지지만 정해진 교체주기는 없음.

Q10) 실적 전망은?

A10) 2022년 대비 매출 10~20% 성장, 마진은 2022년 이상 목표.